

智慧電子人才應用發展推動計畫

110 年度中長期養成班入選班級

◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 ¹ (元)
1	中華大學學校財團法人中華大學	中華大學先進製程積體電路佈局工程師人才養成班	1,000,000
2	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位嵌入式 AI 應用人才養成班	800,000
3	正修學校財團法人正修科技大學	半導體廠務工程師人才養成班	840,000
4	艾錫科技有限公司	生醫訊號處理工程師人才養成班	700,000
5	南台科技大學	新世代無線通訊應用工程師人才養成班	590,000
6	財團法人自強工業科學基金會	自強實體設計佈局整合工程師人才養成班	1,000,000
7	國立高雄大學	高雄大學先進製程整合封裝設備人才養成班	500,000
8	國立臺灣科技大學	臺科晶片佈局人才養成班	600,000
9	義守大學	義守先進製程整合封裝/設備人才養成班	500,000

◎備取班級²

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費(元)
1	中華行動數位科技有限公司	中華行動數位 ARM 智慧物聯網人才養成班	800,000
2	艾錫科技有限公司	嵌入式智能物聯網人才養成班	1,500,000
3	艾錫科技有限公司	機器學習與深度學習應用人才養成班	600,000

¹ 政府經費以每班 20 人估計，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

² 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。